

パワーモジュールの樹脂開封/解析サービス (IGBT等 高耐圧・大電流部品の樹脂開封、評価、解析、分析)

IGBT等のパワーモジュールには、パッケージ封止樹脂に充填剤が多く含まれているなど、樹脂開封が困難なものがあります。
このような“溶解困難なパッケージ樹脂の内部解析したい”というご要望にお応えします。

お客様活用事例

評価／解析／分析 内容

ご依頼[お客様]

お問い合わせ、ご相談

- ・当社技術者がご相談を承ります。お気軽なお問い合わせください(無料)。
- ・お客様のご要望に合わせ、作業内容を提案させていただきます。

作業プラン協議・決定

- ・ご要望内容の確認
- ・作業プランのご提案

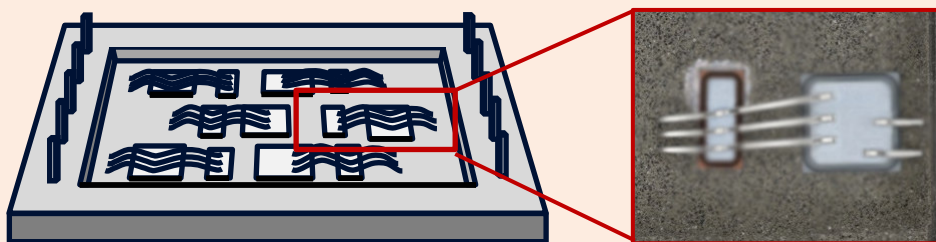
樹脂開封

パッケージ樹脂を薬液等により除去し、内部観察を行います。

樹脂開封トライアル

開封用トライアルサンプルをご提供いただき開封可否を確認

＜パワーモジュールパッケージの開封イメージ＞



チップ露出状態(例)

評価／解析／分析

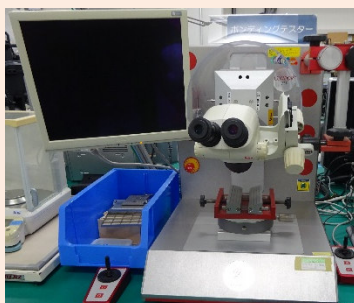
開封後の内部部品に対して、評価／解析／分析などを行います。

樹脂開封・内部観察

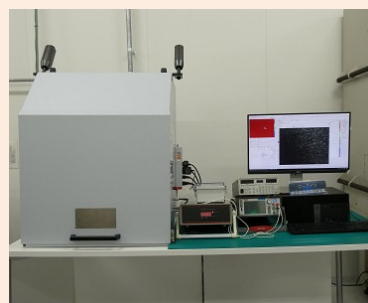
ご要望により開封後の解析や分析、評価等の対応可能

- ・外観観察
- ・SEM観察
- ・SEM-EDX分析など

＜設備の一例＞



ワイヤボンディング強度確認
(ボンディングテスター)



発熱解析によるリーク箇所確認
(赤外線ロックインサーモグラフィ)



観察／分析
(SEM-EDX)

納品

お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く